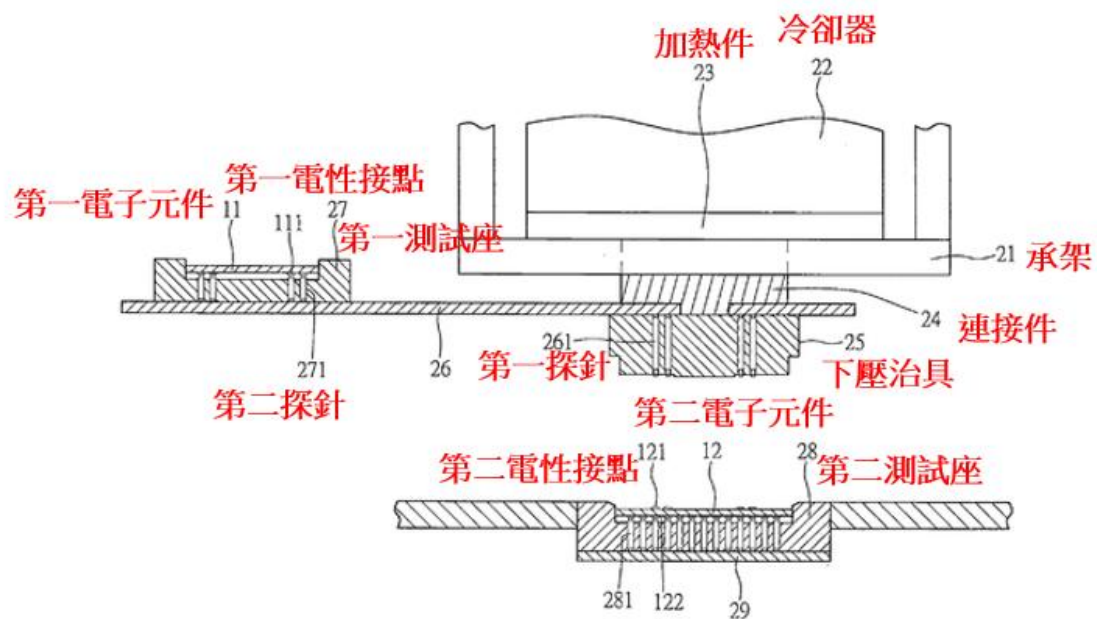
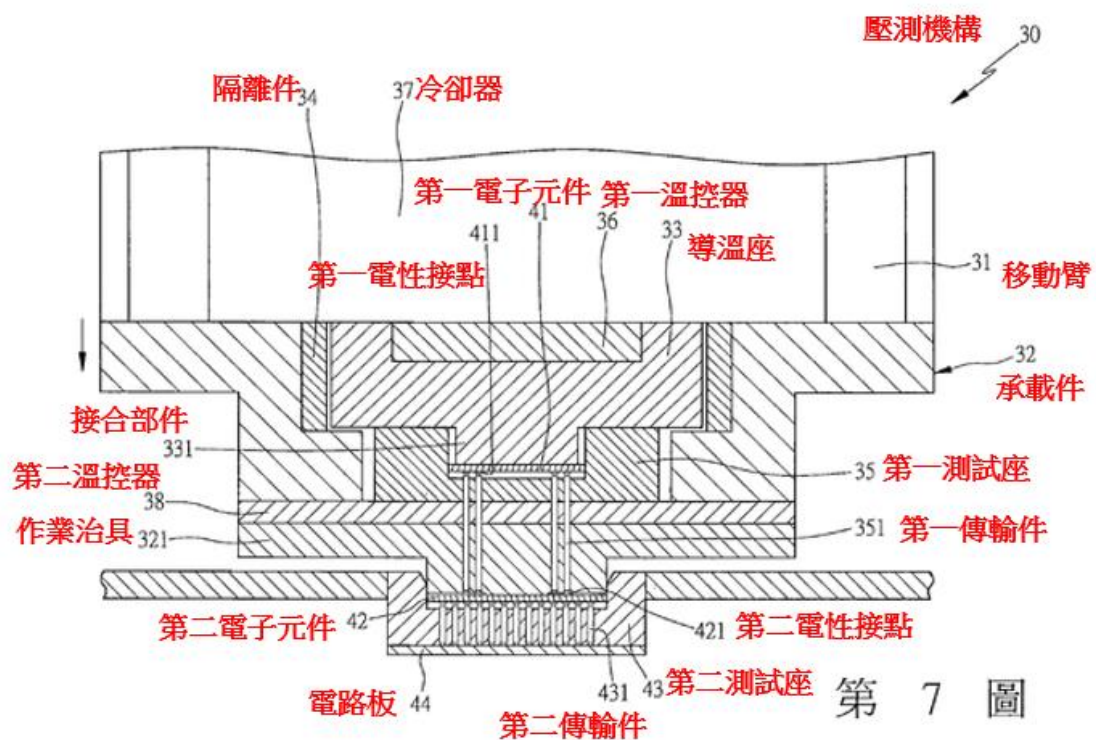


附圖一：系爭專利主要圖式



第 2 圖

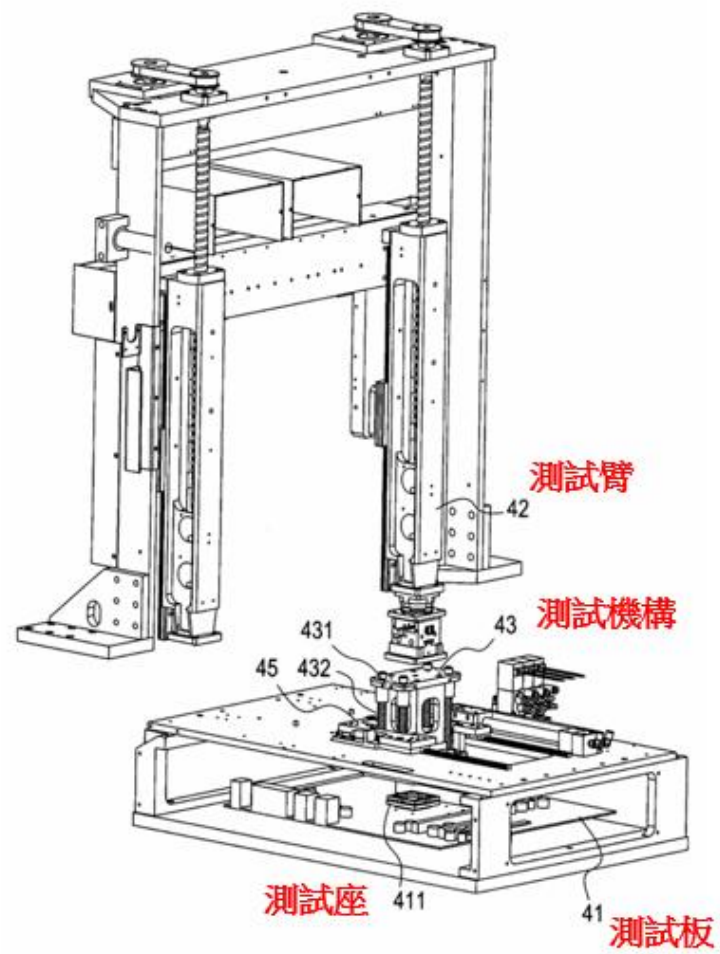
第 2 圖：習知電子元件壓測機構及第二測試座之配置示意圖



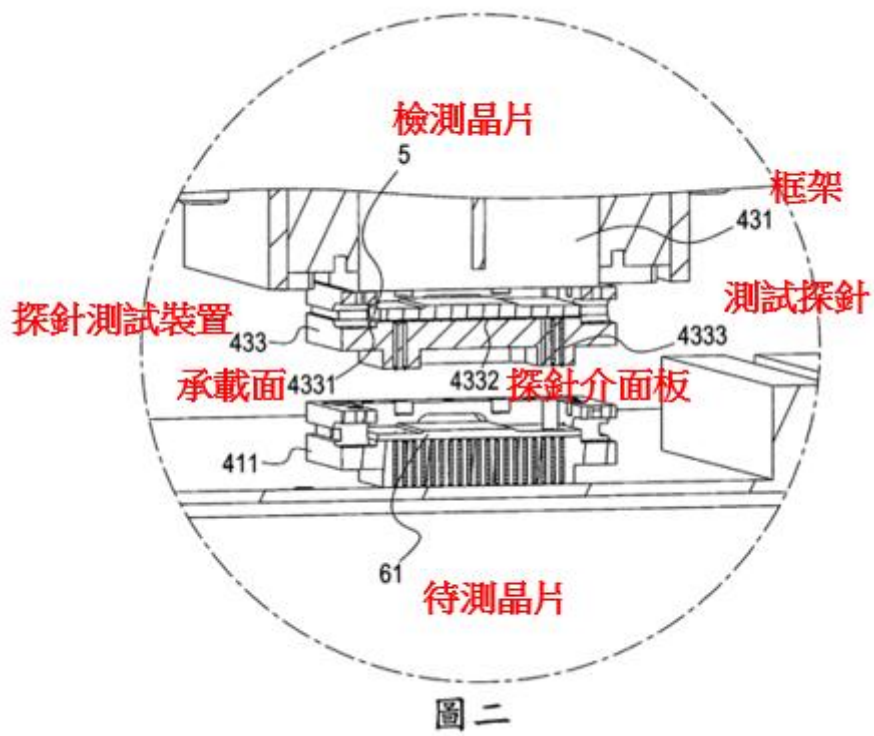
第 7 圖

第 7 圖：本發明壓測機構之使用示意圖

附圖二：證據 1 圖式



圖一 本發明一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台之測試系統結構圖



圖二本發明一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台之測試系統部份結構剖面圖

附圖三：證據 2 圖式

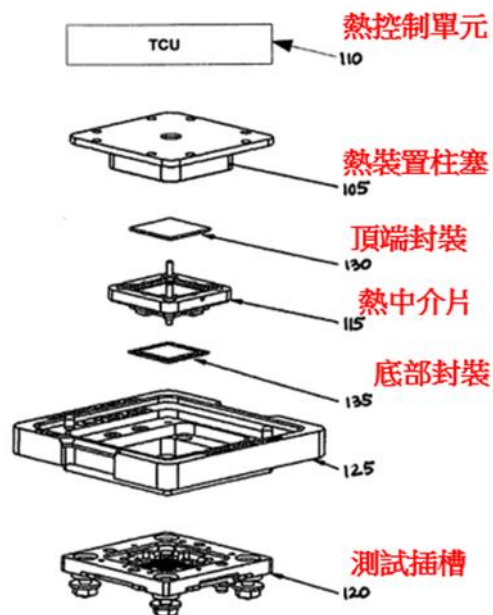


圖 2 係一種併入本發明之示範性熱中介片的示範性系統的方塊圖

附圖四：證據 3 圖式

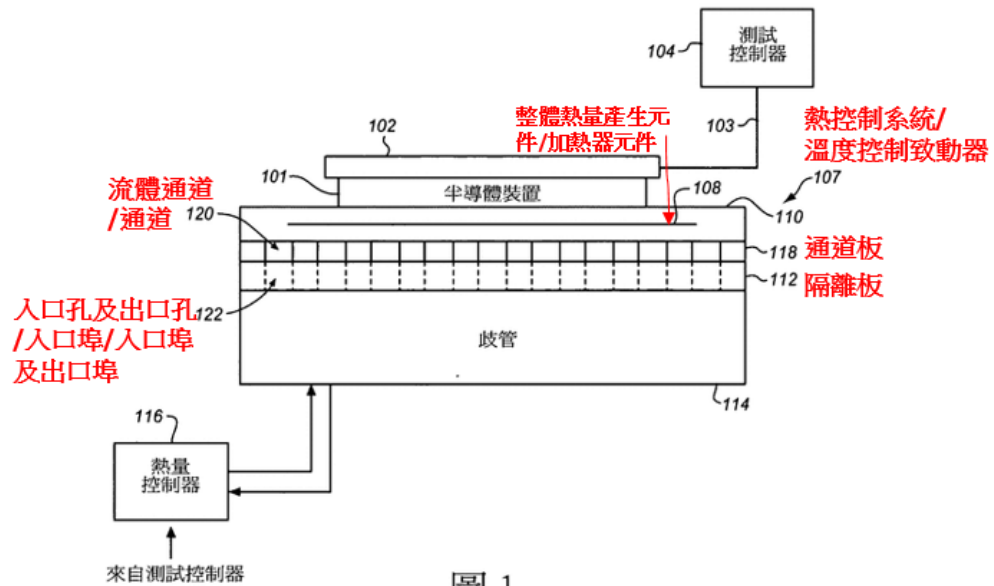


圖 1

圖 1 根據實施例之半導體裝置溫度控制致動器之一部分的側面截面視圖

附圖五：證據 4 圖式

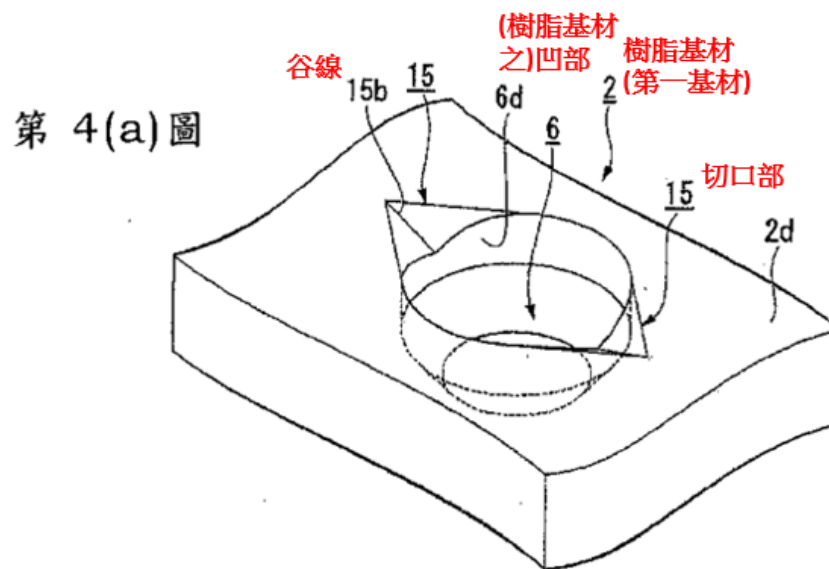


圖 4 樹脂基材之凹部的放大圖，第 4(a)圖為斜視圖

附圖六：證據 5 圖式

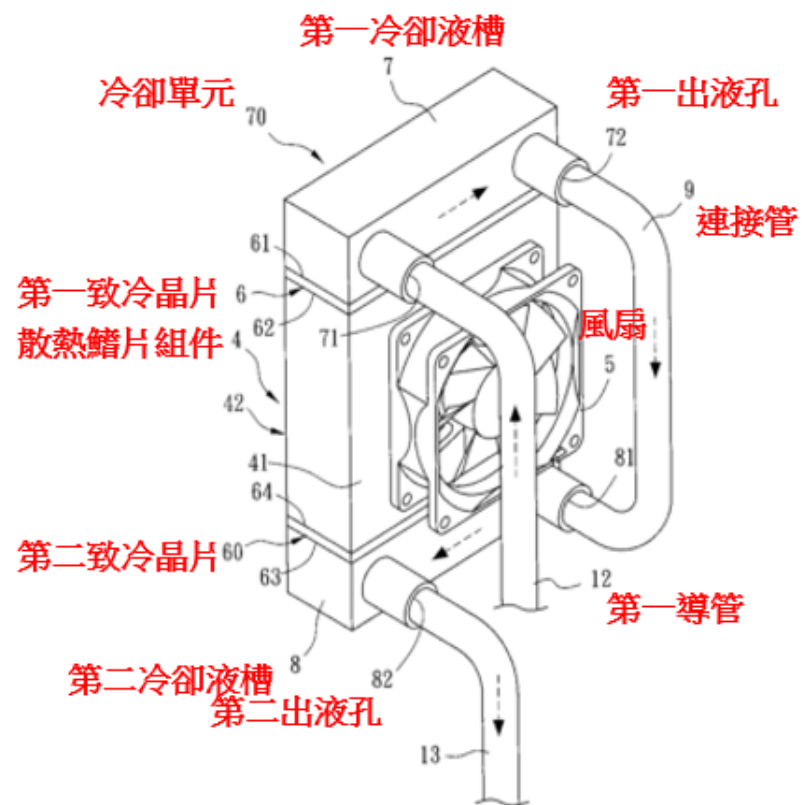


圖 3 是一立體圖，說明該較佳實施例之態樣